

請求の範囲

- [請求項1] 40ppm以上の銅を含み且つ炭素含有量が0.1質量%以下であることを特徴とする、銀粉。
- [請求項2] 前記銀粉中の銅の含有量が40～10000ppmであることを特徴とする、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項3] レーザー回折式粒度分布測定装置により測定した体積基準の累積50%粒子径が1～15 μ mであることを特徴とする、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項4] 前記銀粉の累積50%粒子径(D_{50} 径)に対する、電界放出型走査電子顕微鏡によって観測した単体粒子の平均粒子径(SEM径)の比(SEM径/ D_{50} 径)が0.3～1.0であることを特徴とする、請求項3に記載の銀粉。
- [請求項5] 前記銀粉の累積50%粒子径(D_{50} 径)に対するタップ密度の比(タップ密度/ D_{50} 径)が0.45～3.0g/($\text{cm}^3 \cdot \mu\text{m}$)であることを特徴とする、請求項3に記載の銀粉。
- [請求項6] 前記銀粉中の酸素含有量が0.1質量%以下であることを特徴とする、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項7] 前記銀粉のBET比表面積が0.1～1.0 m^2/g であることを特徴とする、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項8] 前記銀粉のタップ密度が2～6g/ cm^3 であることを特徴とする、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項9] 40ppm以上の銅を含む銀を溶解した溶湯を落下させながら、高圧水を吹き付けて急凝固させることを特徴とする、銀粉の製造方法。
- [請求項10] 前記溶湯中の銅の含有量が40～10000ppmであることを特徴とする、請求項9に記載の銀粉の製造方法。
- [請求項11] 請求項1に記載の銀粉が有機成分中に分散していることを特徴とする、導電性ペースト。
- [請求項12] 請求項11の導電性ペーストを基板上に塗布した後に焼成して導電膜

を製造することを特徴とする、導電膜の製造方法。